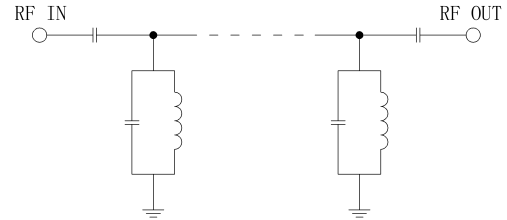


产品特点

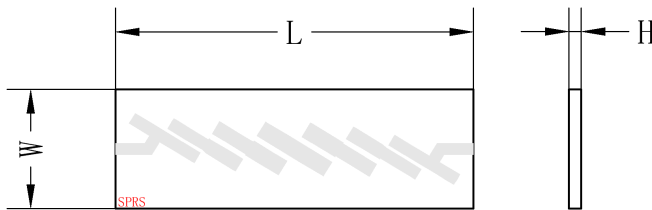
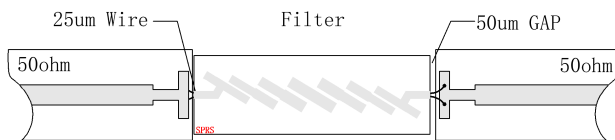
高精度胶片处理技术
高性能, 低温漂, 大功率
陶瓷基板, 50Ω共面波导
金丝键合, 适用于多芯片集成模块

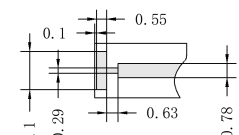
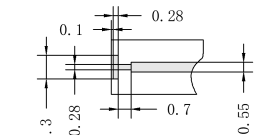

技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.9	GHz
工作带宽	22.5-23.3	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	35@DC-21.4GHz	dBc
带外抑制	40@24.6-34.0GHz	dBc

原理图

其它要求：设计保证

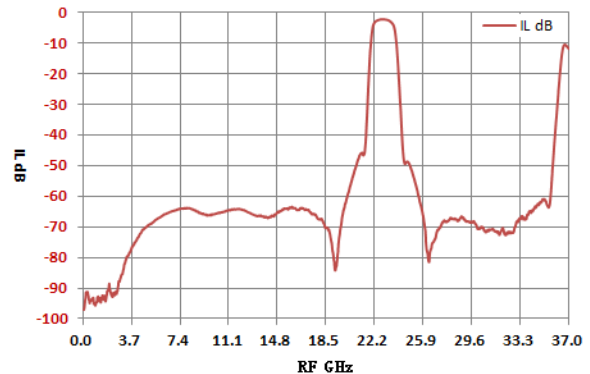
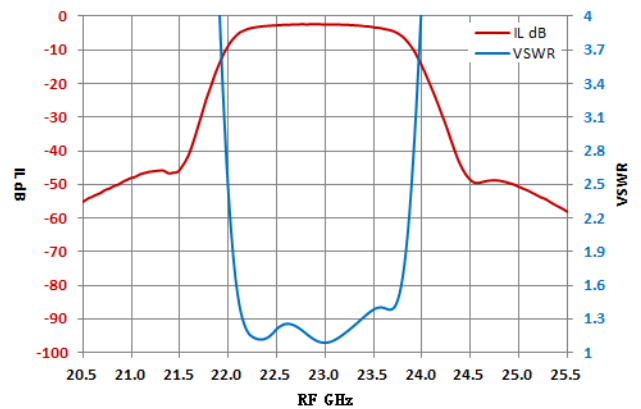
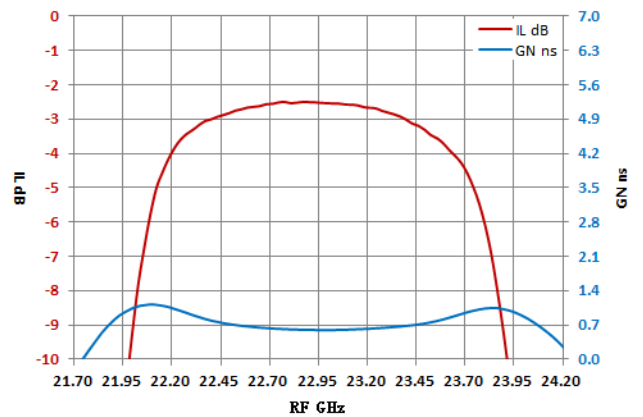
承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85°C
储存温度	-55 ~ +125°C
外形尺寸	L : 6.5 , W : 3.0 , h : 0.26

外形图：端口居中

推荐装配图


PCB Rogers5880, h: 0.254mm	PCB Rogers4350B, h: 0.254mm
	

注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C)载体厚度 ≥ 0.2mm;
- 4: 微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

典型曲线


注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。